

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-09

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	鹏华基金、长城基金、华夏基金、汇添富基金、景顺长城基金
上市公司接待人员	证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：邹云合
时间	2026年5月7日
地点	天风策略会
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2026 年一季度经营业绩情况。</p> <p>2026 年一季度，公司实现营业收入 65.96 亿元，同比增长 37.90%，归母净利润实现 8.50 亿元，同比增长 73.01%，扣非归母净利润累计实现 8.49 亿元，同比增长 75.04%。</p> <p>上述变动主要得益于 AI 算力升级及存储市场需求增长，公司产品结构优化，400G 以上高速交换机、光模块占比同比提升，数据中心收入同比增长，产能利用率提升，叠加广州工厂爬坡顺利，推动营收和利润双增。</p> <p>Q2、请介绍 2026 年一季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>公司在 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2026 年一季度，PCB 通信、数据中心占 PCB 收入占比环比增加；受消费周期影响，汽车电子收入占比有所下降，其余占比维持稳定。</p>

Q3、请介绍 2026 年一季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的封装基板技术能力。2026 年一季度，公司封装基板业务需求较去年第四季度有所增长，其中处理器芯片类封装基板收入增加、占比有所提升，存储类封装基板收入持续增长。

Q4、请介绍公司近期产能利用率情况。

近期公司综合产能利用率处于高位，其中公司 PCB 业务受益于 AI 算力基础设施硬件相关产品需求的增长，工厂产能利用率维持高位；封装基板业务因存储类、处理器芯片类基板需求拉动，工厂产能利用率延续 2025 年四季度以来的较高水平。

Q5、请介绍公司南通四期及泰国项目爬坡进展。

泰国工厂与南通四期项目于 2025 年下半年顺利连线投产，目前产能正稳步爬坡。因为该项目仍处于爬坡早期阶段，在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高，会对公司利润产生一定影响。公司将持续加强内部能力建设，提前做好潜在难点识别，加快重点客户项目引入进程，尽可能缩短爬坡周期，为业务的进一步拓展提供支持。

Q6、请介绍公司广州封装基板项目爬坡进展。

2025 年以来，公司广州封装基板项目产品线能力持续提升，其中 BT 类封装基板产能爬坡稳步推进，FC-BGA 类封装基板已实现 22 层及以下产品量产，24 层及以上产品技术研发及打样工作按期推进。

Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2026 年继续受到大宗商品价格变化的影响，覆铜板、铜箔、金盐等关键原材料价格同步上行，对公司盈利水平构成一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格

	<p>传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>Q8、请介绍公司 2026 年资本开支的方向。</p> <p>2026 年公司资本开支主要聚焦 PCB 与封装基板业务，重点投向无锡高速高密、高多层电子电路产品项目、广州封装基板工厂建设，以及南通四期、泰国工厂项目后续款项支付；同时适时开展技术改造，打开瓶颈、释放产能。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>